

先進封裝產業現正蓬勃發展中

先進封裝及系統集成研討會 06/20-21 無錫古運河畔日航大酒店



無庸置疑的，先進封裝產業正在發生變化。新興的應用帶來了許多新的挑戰。來自世界各地的封裝專家積極參與了創新解決方案的開發，以因應以大趨勢為主導的市場需求。“大趨勢 Megatrend 可能會成為先進封裝產業未來 10 年間的關鍵詞，更廣義的說是整個半導體產業”，[Yole Développement \(Yole\)](#) 半導體和軟件部門總監 Emilie Jolivet 評論道。“人工智能、物聯網、5G，移動通訊等..... 我們這個世紀的所有主要應用如今都是這些產業的新驅動力。”

大趨勢對先進封裝產業的影響究竟是什麼？我們是否可以期待先進封裝公司從傳統業務往創新服務/產品發展，以回應大型細分市場區隔需求的強勢舉措？先進封裝供應鏈將如何發展？

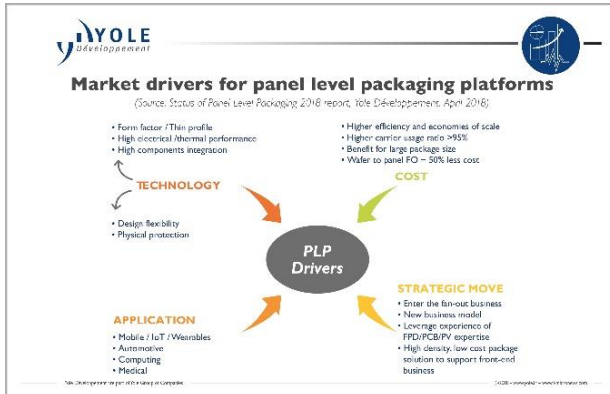
市場研究和戰略諮詢公司 Yole 進行了先進封裝行業的綜合研究，同時將高端行業和大趨勢的發展列入考量。Yole 的半導體和軟件部門持續與領先的半導體廠商進行常態討論，以了解技術發展，掌握技術突破，並與日常生活中發生的科技革命如自動駕駛車輛、駕駛輔助系統 ADAS、5G、AI 人工智慧等進行連結..... 以強大的技術專業知識為基礎，搭配豐富的產業知識和專業的方法論，Yole 在全球主要貿易展覽和會議期間通過專門的技術和市場報告、網絡廣播和演示展示其對該產業的展望。

隸屬於 JITRI 的 NCAP 和 Yole 邀請您參加第四屆先進封裝和系統集成技術研討會。

這個為期兩天的會議，將於 2018 年 6 月 20 日和 21 日在中國無錫舉行。會中將針對戰略問題提出解答，並有機會與先進封裝產業的領導者會面交流。

在過去四場成功的活動之後，Yole Développement 與 NCAP 決定繼續加強合作，以再次提供包括面板級、扇出 FO、系統級封裝 SiP、先進基板，及 3D 封裝技術在內的完整活動內容。大趨勢將成為 NCAP 主辦的此次會議的核心。先進封裝產業發展是現在進行式。千萬不要錯過此次活動！

- 點擊 [program & registration](#) 以查看日程時間表、講者名單，摘要和更多資訊。
- 2018 年研討會由 DIPSOL、ERS、Nordson、SPTS 和 SEMSYSCO 贊助。



於 2014 年首次舉辦的先進封裝與系統集成技術研討會每年吸引超過 180 位全球高管參加。該計劃由 Yole 和 NCAP 共同合作規劃，匯集了眾多有價值的討論，短期課程，會議和商業合作。主講人名單令人印象深刻（**講者名單**：[Full list of speakers](#)）。2018 年的議程邀請了包含以下兩位在內的講者進行主題分享：

- **產業趨勢對先進封裝的影響** - Yole 集團總裁 Jean-Christophe Eloy。Yole 集團公司旗下包括 Yole Développement、System Plus Consulting、KnowMade 和 PISEO。
- **創新晶圓級扇出技術的工業化道路**：eSiFO - 華天科技電子副總裁于大全博士

除此之外還有更多豐富的活動內容，期待您共襄盛舉。講者名單、簡歷和摘要的列表可在 i-micronews.com 網站找到。下載 PDF 版本，請點選 [Program](#) - [Abstracts](#)。

在 2018 先進封裝與系統集成技術會議的眾多場次中，將由 ERS 電子首席執行官 Klemens Reitering, KLA-Tencor 高級營銷總監 Stephen Hiebert 和 David Butler，SPTS 技術部執行總經理等多位嘉賓探討分享晶圓級扇出封裝 FOWLP 的最新技術趨勢。

目前晶圓級扇出封裝是增長最快的封裝平台，並受到大趨勢的直接影響。從移動通訊到汽車到醫療，不論是低端（如音頻編解碼器）或高端設備（如 APU），Yole 都持續常態性的進行技術發展和市場驅動因素的分析。“截至目前為止，與其他更成熟的封裝平台相比，成本仍然是一個問題”，Yole 的高級分析師 Santosh Kumar 表示。這部分的市場趨勢和技術挑戰將由 Santosh Kumar 在專門的場次中詳細介紹。Santosh 近期曾邀請 Evatec 先進封裝業務部門的主管 Albert Koller 來討論最新動態並展示其對先進封裝產業的展望。這次訪談可以在 i-micronews.com, [advanced packaging news section](#) 部分閱讀。

NCAP 總經理曹立強博士表示：“近年來，全球先進封裝的許多方面仍以扇入 FI、扇出 FO、矽穿孔 TSV 和晶圓級封裝 WLP 為重點.....就中國而言，我們已確定未來五年扇出 FO 技術開發和商業化部分將有重大變化。封裝廠將有望在中國本地建立。NCAP 正在與我們多年來的合作夥伴一起為扇入及扇出的批量生產製造做準備.....借助 Yole，NCAP 正在探索與全球設備和材料供應商的可能合作機會。此類研討會是與 OSAT 封測廠和最終用戶互動的真正機會。在 NCAP，我們相信 NCAP-Yole 的協作將對先進封裝產業帶來正向的影響，並達到鼓勵其發展的效果。在研討會期間，我們特別期待激發許多有關國內封裝材料和設備市場所面臨的眾多挑戰、5G 環境需求、封裝廠創新技術開發等等的熱烈討論。”

此次研討會為先進封裝業者擴大其在中國和其他國家的活動提供了一個令人興奮的契機。NCAP 和 Yole 對 2018 年的活動抱以厚望。立刻線上註冊報名保留席位 [Registration](#) 或洽 veyrier@yole.fr。查看完整議程時間表請點擊：[Program](#)

##{